

明新學校財團法人明新科技大學積體電路封測學程實施細則

107年05月16日臨時教務會議訂定

108年03月27日教務會議修正

108年06月12日臨時教務會議修正

- 第一條 依據「明新學校財團法人明新科技大學專業學分學程實施辦法」之規定，訂定明新學校財團法人明新科技大學「積體電路封測學程實施細則」（以下簡稱本細則）。
- 第二條 本細則配合政府推動半導體產業的政策成立此積體電路封測學程（以下簡稱本學程），宗旨在於持續開授半導體應用技術相關課程，培育積體電路設計、元件量測、積體電路測試、積體電路封裝實務應用、積體電路產品可靠性等之專業人才。
- 第三條 本細則適用對象為明新學校財團法人明新科技大學學生。
- 第四條 本學程課程規劃分為三大類：

課程分類	課程名稱	開課系所
基礎課程	電子學(一) (3學分/3小時)	電子系、電機系
	電子學(二) (3學分/3小時)	電子系、電機系
	積體電路設計(3學分/3小時)	電子系
	數位系統設計 (3學分/3小時)	電子系
	數位邏輯設計 (3學分/3小時)	電機系、資工系、電子系
	品質管理 (3學分/4小時)	工管系
	材料科學與工程 (3學分/3小時)	電機系、化材系
	積體電路封裝導論 (3學分/3小時)	電子系
核心課程	信號與系統 (3學分/3小時)	電子系
	數位信號處理 (3學分/3小時)	電子系
	電子構裝冷卻概論 (3學分/3小時)	機械系
	材料分析 (3學分/3小時)	化材系
	半導體製程材料分析 (3學分/3小時)	光電系、化材系
	積體電路工程 (3學分/3小時)	電子系
	積體電路測試實務 (3學分/3小時)	電子系
	積體電路封裝實務 (3學分/3小時)	電子系
	電動機機械 (3學分/3小時)	電機系
核心課程	品質工程 (3學分/3小時)	工管系
	半導體製造管理 (3學分/3小時)	工管系
應用課程	半導體封裝材料概論 (3學分/3小時)	光電系、化材系
	積體電路封裝與測試 (3學分/3小時)	電子系
	積體電路可靠性工程 (3學分/3小時)	電子系
	高階積體電路封裝與模擬 (3學分/3小時)	電子系
	智慧電網 (3學分/3小時)	電機系
	微控制器應用與設計 (3學分/3小時)	電機系
	數位控制器設計 (3學分/3小時)	電機系
	品質管理實務應用 (3學分/3小時)	工管系
	電子特用化學品 (3學分/3小時)	化材系
	封裝現場工程管理實務 (3學分/3小時)	工管系

第五條 學生修習本學程符合下列規定者得申請本學程證書：

- 一、基礎課程至少修習一門課程。
- 二、核心課程至少修習二門課程。
- 三、應用課程至少修習一門課程。
- 四、至少修滿18學分。
- 五、跨系選修至少3學分。

第六條 本細則如有未盡事宜，得依本校專業學分學程實施辦法辦理。

第七條 本細則經教務會議審議通過，陳請校長核定後發布實施，修正時亦同。